

**Datenblatt**

mehrlagige Leiterplatten

Multilayer

MLL4/MLL6/MLL8

Basismaterialien	Standard FR4	
	Anzahl Lagen (typisch) (höhere Lagenanzahl möglich)	bis 8
	min. End-Kupfer-Dicke	35 µm
	max. End-Kupfer-Dicke	105 µm
	T <sub>g</sub>	130/150/170 °
Layout	Strukturbreite	150 µm
	Strukturabstand	150 µm
	uml. Löstopplack-Freistellung	125 µm
	kleinster Löstopplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	150 µm
	kleinste Bohrung (Via)	300 µm
	kleinster Fräsradius	500 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
	Durchkontaktierung	> 20 µm
Kantenmetallisierung	möglich	
Oberfläche	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
	chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold Carbondruck	
Löstopplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	Durchsteigerfüller	
	abziehbare Lötdeckmaske Kaptonband, hitzebeständig bis 260°C	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
	Filme Musterplatinen	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2008	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		